



H6042

双组份有机硅灌封胶

H6042 是一种双组份缩合型室温固化硅橡胶，可常温固化，固化过程中放出乙醇分子，对 PC、PP、ABS、PVC、铜线等材料不会产生腐蚀。对大部分电子配件材料（PP、PE 除外）附着力良好。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	硅胶
外观	黑灰色液体
组分	双组分 (A:B=10:1)
固化方式	室温
应用	灌封、保护

产品优点

- 优异的流动性；
- 耐热性、耐潮性、耐寒性优秀，应用后可以延长电子配件的寿命。
- 可拆卸性，密封元器件可取出更换，再灌胶修补不留痕迹。
- 本产品无须使用其它的底漆，对 PC、Epoxy 等材料具有出色的附着力，可达到 IP67 防水等级。
- 完全固化后的材料绝缘防潮、防霉、耐酸碱、耐紫外线、抗老化性能好，耐高低温(-50-200℃)，能长期稳定工作。
- 完全符合欧盟 ROHS、UL (E488095) 指令要求。

产品应用

用于(柔性、刚性)线路板、LED 电源、防水电源、汽车电子模块、光源、灯具及其附属器件的灌封保护。特别是有粘结性要求的灌封。

产品性能

未固化时性能

条目	H6042A	H6042B	备注
外观	黑色或灰色	透明	/



粘度 cps	5,000±500	50±10	ASTM D2196
密度 g/cm ³	1.25	0.98	ASTM D792
混合比例	A:B=10:1		/
混合后粘度 cps	3000~3500		ASTM D2196
表干 min	60~90		@25℃
初步固化 h	1		@25℃
完全固化 h	4~8		@25℃
导热系数 w/m.k	0.6~0.8		ASTM D5470

固化后性能:

条目	典型值	备注
物理性能	硬度 Shore A 35±5	ASTM D2240
	体积电阻率 Ω . cm 1.0×10^{15}	ASTM D257
	介电损耗 @ 1MHz 0.01	ASTM D150

操作指南

1. 混合之前:

A 组份需要使用手动或机械设备在转速 1500-2000 转/分的条件下在桶内搅拌 5-7 分钟。搅拌器应置于液面中心位置，搅拌器插入胶内深度最好为胶液深度的 1/2-2/3。B 组份应在密封状态下左右摇动 5-7 次，然后再使用。

2. 混合时:

重量比为 A: B = 10: 1，如需改变比例，应事先进行试验后方可实际应用。一般 B 组分用量越多，操作时间与固化时间越短。环境温度越高，操作时间与固化时间越短。一般不建议加热，以免表面及内部产生针孔或气泡，影响产品的美观及密封性能。

3. 配好的胶液，必须在凝胶（明显增稠）前用完，否则会造成浪费或影响灌封效果。

注意事项

1. 胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
2. 本品属非危险品，但勿入口和眼。
3. 长时间存放后，胶中的填料会有所沉降，请搅拌均匀后使用，不影响性能。



标准包装

- 22kg/套 (A 组份 20kg+B 组份 2kg)
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：8~25℃，储存期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。



湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区诸园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com